

Dr. Krammer Olivér
Önéletrajz



Egyetemi jogviszony	egyetemi docens 2015 - adjunktus 2008 - 2015.
Kutatási területek	Elektronikus áramkörök kötéseinek megbízhatósági vizsgálatai Forrasztásanyagok fizikai- kémiai tulajdonságai Forrasztási technológiák
Tanulmányok	Villamosmérnöki Ph.D. képzés 2005 - 2010. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola - Mikroelektronika és technológia szakmacsoport Okleveles villamosmérnöki képzés 1999 - 2005. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar - Főszakirány: Mikrorendszerek és Moduláramkörök Mellékszakirány: Stúdiótechnika és akusztika Technikus képzés 1998 - 1999. Újpesti Műszaki Szakközépiskola Számítástechnikai és Informatika szak Műszaki szakközépiskolai képzés 1994 - 1998. Újpesti Műszaki Szakközépiskola
Nyelvvizsgák	Német alapfokú (B1) / Írásbeli (B) 2010. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Német alapfokú (B1) / Szóbeli (A) 2010. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Angol középfokú (B2) / Komplex (C) 2004. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

**Szervezeti,
szakmai tagság**

International Spring Seminar on Electronics Technology

2012 -

Steering Committee titkár

International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)

2011 -

Steering Committee tag

IEEE - Components, Packaging and Manufacturing Technology Society

2008 -

tag

**Szakmai
tapasztalat,
tevékenység**

Erasmus+ projekt résztvevő, MECA - MicroElectronics Cloud Alliance, 562206-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-KA

2016. január -

Közreműködők: Koordinátor: Technical University of Sofia (Bulgária)

Leonardo LLP projekt témavezető, VAPAEAT - Virtual And Practical Applications to Electronic Assembling Technology, 2013-1-TR1-LEO05-47531

2013. december - 2015. november

Közreműködők: Koordinátor: Turgut Özal University (Törökország)

<http://www.vapaeat.com/>

FP7-ICT-2011-8 projekt témavezető, EUROTRAINING - Provision of a European Training Infrastructure, FP7-ICT-2011-8 No. 316526

2013. január - 2015. december

Közreműködők: Koordinátor: FSRM (Svájc)

<http://www.eurotraining.net/>

Bevonattal ellátott réz áramkivezetők mechanikai és felületi tulajdonságainak hőkezelés hatására bekövetkező változásának kutatása, témavezető

2011. november - 2012. február

Közreműködők: Infineon Technologies Bipoláris Kft., Cegléd

Magas hőmérséklettűrésű huzalkötéssel kikötött félvezető chippek törésmechanizmusának kutatása, témavezető

2011. április - 2011. december

Közreműködők: Infineon Technologies Cegléd Kft.

Termoszónikus arany huzalkötések vizsgálata

2011. január - 2011. október

Közreműködők: Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan

Rendszerforrasztás zárványképződési folyamatának kutatása

2010. január - 2010. október

Közreműködők: Infineon Technologies Cegléd Kft.

**Szakmai
tapasztalat,
tevékenység**

Stencil deformációk végelem módszereken (FEM) alapuló vizsgálata

2008. október - 2009. május

Közreműködők: Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan

Leonardo LLP projekt résztvevő, ELECT2EAT - E-Learning Education and Continuing Training to Electronics Assembling Technology, LLP-LdV-TOI-2007-HU-016

2007. november - 2009. október

<http://elect2eat.eu/>

BGA tokozású alkatrészek forrasztásainak mechanikai vizsgálata

2007. október - 2008. április

Közreműködők: Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan

Pin-in-paste gyártástechnológia fejlesztése

2006. november - 2007. november

Közreműködők: Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan

Ólommentes elektronikai forrasztási technológiák fejlesztése

2006. január - 2007. június

Közreműködők: Continental Budapest Temic Hungary Kft.

EU-FP6, IST Integrated Project projekt résztvevő, CLEAN - Controlling Leakage power in Nano CMOS SoCs, EU-FP7-IST-4-026980

2005. november - 2008. október

Közreműködők: Koordinátor: STMicroelectronics SRL (Olaszország)

<https://www.edacentrum.de/en/projects/CLEAN>

http://cordis.europa.eu/project/rcn/80561_en.html

Ph.D. kutatás - Felületszerelt Passzív Alkatrészek Forrasztásának Modellezése és a Kötések Mechanikai Vizsgálata

2005. szeptember - 2010. május

EU-FP6, IST CRAFT projekt résztvevő, FlexNoLead - Flexible Circuits Processing, Performance and Reliability using Lead-Free Soldering Process, COOP-CT-2004-513163

2005. február - 2007. április

Közreműködők: Koordinátor: TWI Ltd. (Egyesült Királyság)

http://cordis.europa.eu/project/rcn/72289_en.html

Diplomatervezés - Újraömllesztéses forrasztás optimalizálása ólommentes környezetben

2005. február - 2005. június

Szakmai gyakorlat - Újraömllesztéses forrasztás optimalizálása, forrasztási hibák számának csökkentése

2005. január - 2005. június

Közreműködők: Videoton Holding RT (VEAS)

Szakmai tapasztalat, tevékenység	EU-FP6, IST CRAFT projekt résztvevő, EMCI - Embedded Micro Connector Injection Process, COOP-CT-2003-508172 2004. november - 2007. január Közreműködők: Koordinátor: I.T.C. Intercircuit Electronic GmbH. (Németország) http://cordis.europa.eu/project/rcn/72218_en.html EU-FP6, IST Collective Research projekt résztvevő, LEADOUT - Low Cost Lead-Free Soldering Technology to Improve Competitiveness of European SMEs, COLL-CT-2004-500454 2004. szeptember - 2007. november Közreműködők: Koordinátor: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugália) http://cordis.europa.eu/project/rcn/79198_en.html
Egyéb díjak, szakmai elismerések	Dékáni dicséret a Villamosmérnöki és Informatikai Kar érdekében végzett kiváló munkáért 2014. IEEE-CPMT elismerés a jelentős hozzájárulásért az IEEE CPMT Hu-Ro chapter tevékenységéhez 2014. Elismerő oklevél a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában Garami Tamás által bemutatott pályamunka témavezetői tevékenységéért 2013. Oklevél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2012. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján I. helyezést nyert Garami Tamás "Bizmut és antimon mikroötvözőkkel adalékolt forraszok vizsgálata" című dolgozat szakmai irányításáért 2012. Excellent Poster Award - Comparing the Intermetallic Layer Formation of Infrared and Vapour Phase Soldering - 34th International Spring Seminar on Electronics Technology, (ISSE), High Tatras, Slovakia 2011. Excellent Poster Award - Stencil Deformation during Stencil Printing - 15th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, (SIITME), Gyula, Hungary 2009. http://siitme.ro/2015-edition/award-winners/ Best Poster Award - Investigating the shear strength of chip component solder joints - 14th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, (SIITME), Predeal, Romania 2008. http://siitme.ro/2015-edition/award-winners/

**Egyéb díjak,
szakmai
elismerések**

Best Paper Award - Measuring Methods of Solder Paste Hole-Filling in Pin-in-Paste Technology - 13th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, (SIITME), Baia Mare, Romania
2007.

<http://siitme.ro/2015-edition/award-winners/>

Diplomaterv pályázati díj, III. helyezés
2005.